

平成16年12月8日

報道各位

## 三井金属 特殊電解銅箔の増産に向け国内休止設備を再稼動

～05 上期より上尾第2工場を特殊箔専用ラインにリニューアルし稼動開始～

当社 三井金属(社長 榎原 紘)は、特殊電解銅箔に特化した国内の上尾工場において、当該商品の需要増を見込み、2005年度上期より現在休止中の工場設備(第2工場)を再稼動することに決定いたしました。

既に当工場では、生産ラインのリニューアルなど再稼動に向けた諸準備を開始しております。

### <上尾第2工場の再稼動>

このたび再稼動するのは、電解銅箔事業の国内拠点である上尾工場(埼玉県上尾市)内にある第2工場と称するプラントです。当工場は、2001年に休止するまでは、汎用箔(厚さ35マイクロメートルが中心)の生産ラインでしたが、今回の再稼動にあたり最新鋭のハイエンド特殊電解銅箔(厚さ9~12マイクロメートルが中心)専用工場としてリニューアルいたします。高度な品質信頼性が要求される特殊な商品群を生産可能とするラインを整えた工場となり、2005年7月頃、稼動開始を予定しています。

### <投資額・生産能力>

第2工場のリニューアルには、総額約50億円の投資を今後3~4年の間に順次行ってまいります。投資が完了した時点での実生産能力(歩留りを含めた実際に量産可能な能力)は、現在の月産240万㎡から、80%増の月産430万㎡に増強されます。これに向けた第1ステップとして、2005年度上期中には、20%増の月産290万㎡の能力増強を完了する予定です。

### <商品の需要動向>

当社の特殊電解銅箔(1)は、ファインパターン(微細回路)の形成性と屈曲性に優れた配線材料として、現在、多くがフレキシブル電子回路基板(FPC)やTAB向けに用いられ、軽量・極薄・小型化が強く求められる携帯電話・デジカメ・DVD・液晶テレビなどのデジタル機器に広く採用されております。

特に最近、ファインパターン化と生産性を両立する材料として、厚さ9~12マイクロメートル、幅1.3メートルの極薄かつ広幅の商品分野の需要が拡大しつつあります。新たな需要としては、従来、圧延銅箔が使用されていた携帯電話のヒンジ部への本格採用の開始(2)や、プラズマディスプレイ電磁波シールド材(3)としても高い評価を得ています。また、昨年開発したCOF向けの超ファインパターン用(4)にも、液晶パネルの実装技術の進展に伴い需要が急速に伸びています。

これら拡大する需要傾向は、顧客の引き合いの状況から今後も継続が見込まれる状況にあります。

### <上尾工場の位置付けと今後>

これまで当社は、2001年のITバブル崩壊を契機に、グローバルな電解銅箔事業の再構築を実行してまいりました。特に、汎用箔の市況悪化の影響を大きく受けた上尾工場に対し大幅な生産体制の変更を行い、第1と第2の各工場を休止（5）し最盛期の生産能力の3分の1まで縮小いたしました。

しかし、当該商品の需要拡大が今後も見込まれる中、能力増強の限界に達していた現体制を補うため、このたび第2工場の再稼働を決定いたしました。これにより上尾工場では、ICパッケージやTAB向けの商品生産で培ってきた高度な工程制御能力と品種開発能力を更に拡充し、今後とも最高難度の商品における安定生産技術の開発に取り組み電子材料の性能向上に更に貢献してまいり所存です。

1. 当社の特殊電解銅箔...主力ブランド「VLP」並びに「SHTE」をベースに、これに微細回路用の特殊な表面処理技術を各種組み合わせ、用途別に最適化を図った商品群で構成。品種は数十種類以上に及び。
2. 携帯電話のヒンジ部への本格採用...当社の代表品種名 3EC-M3S-HTE
3. プラズマディスプレイ電磁波シールド材...当社の代表品種名 TQ-M2-VLP
4. COF向けの超ファインパターン用...当社の代表品種名 NA-VLP
5. 第1と第2の各工場を休止...当時、両工場が生産していた汎用箔は、全て当社の海外工場（台湾・マレーシア）に移管。

以 上

### 【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室 <sup>ひじや</sup> 泥谷・浅木 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029  
Eメール koho@mitsui-kinzoku.co.jp